

중소그룹 부품소재, 차세대성장형으로 변신

B그룹은 10년간 전자 부품·소재·장비 사업을 신성장동력으로 육성했다. 과감한 인수합병 등을 통해 5개의 계열사를 거느렸지만 성적표는 초라하다. 이 중 가는 지난해에 이어 올해 적자가 이어졌다. 나도 3분기에 영업적자로 돌아섰다. 지난해 인수한 다는 첫해부터 적자를 걱정해야 할 판이다. 라를 제외한 대부분 계열사의 사정이 어렵다. 오너 일가가 외부지분 7.3%를 보유해 얻는 지분법 평가의 1400억원과 비교하면 사업성과는 더욱 미흡하다.

지난 1990년대 말부터 부품·소재 사업에 진출한 중견 그룹사들에 대한 평가가 다소 부정적이다. 매출 규모가 조 단위에 이르는 데다 전통산업인 섬유·화학 업종의 중견 그룹사들로선 손쉽게 진입할 수 있다고 여겼지만 현실은 냉혹했다. B그룹 관계자는 지금으로선 안정적인 생존이 우선이라며 당분간 과거처럼 적극적인 투자가 힘들 것이라고 말했다.

D, E, F, G 등 반도체·디스플레이용 소재 사업에 일찌감치 발을 디딘 회사들도 최근 회의론에 휘말렸다. D는 올 들어 합작으로 폴리이미드 필름 사업을 떼어냈다. 광학필름 사업의 진로도 불투명하다. E의 광학필름 사업도 아직 국내 고객사에 진입하지 못했다. 인쇄회로기판용 동박사업도 정체다. F는 올해 매출 1조 원대를 바라보며 외형상 양대 주력 계열사지만 그룹 내 평가는 차갑다. 주력인 TV용 백라이트유닛 사업은 박한 마진구조에 시달리는 전형적인 위탁가공업이다. G는 올 들어 10여개 전자 부

품·소재 기업들을 인수하며 적극적이지만 아직은 이렇다 할 성과를 장담하기 이르다. 이 중 한 공장은 화학 사업에서 벗어나 최근 디스플레이용 필름 시장 진출을 선언했지만 대규모 양산 공급은 불투명하다.

화학·섬유 등 전통 산업은 제품 사이클이 뚜렷해 지속적인 원가 경쟁력만 확보하면 늘 안정성을 유지할 수 있다. IT 산업은 시스템과 디바이스의 교체 주기가 워낙 빠르다. 막대한 투자를 통해 기술을 개발하고, 양산해도 선발 주자가 한참 앞서 가 원가 경쟁력을 갖기 힘들다. 전통 산업에 익숙했던 의사결정 구조와 비즈니스 논리가 IT 시장에서 통하지 않는다는 뜻이다.

삼성·LG라는 우산을 쓰지 않으면 초기 시장 진입도 어렵다. H, I 등이 지금처럼 글로벌 경쟁력을 확보한 것도 캡티브 마켓이 있었기에 가능했다. 두 회사의 경우 초기 시장 진입때 그룹내 관계사의 전략 파트너로 공동 연구개발에 참여했으며, 구매 물량을 일정 정도 보장받으면서 기술·양산 경쟁력을 키워올 수 있었다.

투자 규모도 중견 그룹사가 감당하기엔 벅차다. 핵심 원천 기술도 없으니 막대한 투자를 단행하고도 추격자지위를 벗어나기 힘들다. “지난 10년 동안 한두 개 기업이라도 성공한 사례를 보여주지 못했다” 라면서 결국 두 가지 핵심 역량인 마케팅력과 기술력 가운데 하나라도 제대로 갖춘 회사가 드물기 때문이라고 지적됐다.

삼성·LG에 국한되긴 하지만 IT 부품·소재 시장

에서 국내 기업들의 역할을 낙관하는 시각도 있다. 당장 엄청난 실적을 이루지는 못했지만 삼성전자가 장기적이고 전략적인 파트너로 끌고 갈 수밖에 없는 곳이라며 일본 업체와 비교해도 상당한 기술력을 다진 상황이라고 관계자가 말했다. LG화학이 전자재료 사업에서 지금 두 자릿수의 이익률을 내는 것은 세계 시장서도 드문 일이라며 대만계 업체들이 어려움을 겪는 것과 극히 대조적이라고 지적했다.

중견 그룹들이 사양길에 접어든 부품·소재 사업에서 철수하거나 전통 산업에서 아예 IT 부품·소재 기업으로 과감하게 변신하는 것도 고민해야할 시점이다. 최근 시장 성숙기에 이른 반도체·LCD 관련 사업보다 차세대 성장 사업에 집중하는 것도 한 방법이다. 태양광 소재 사업에 일찌감치 뛰어든 G그룹이 적절한 사례다. 전자신문에 의하면, 세계 실물경기 위축 속에 유망한 국내외 기업을 인수하는 것도 현실적인 대안으로 떠올랐다.

팹리스업계 해외파운드리 이용 증가

팹리스 벤처기업의 시스템반도체 생산 물량이 해외 파운드리 기업에 급속도로 빠져나가고 있다. 외화 유출은 물론이고 반도체 후공정 산업군인 패키징·테스트 기업 성장의 발목을 잡는 부작용으로 이어질 수 있다는 점에서 주목된다.

업계 및 ETRI SoC산업진흥센터에 따르면 올해 SoC 시제품 개발 지원 사업에 참여한 팹리스 기업의 24개 신 개발품 가운데 해외에서 초기 생산하는 사례가 13건으로 54.1%를 차지했다. 특히 올해 파운드리 의존 수치는 2006년 20% 대비 3배 가까이 늘어난 것이다. 해외 거대 팹리스 기업이 지배한 시장에서 국내 팹리스 산업이 자생력을 갖추는 데 일조한 정부의 'SoC 시제품 개발 지원 사업' 혜택이 정작 팹리스에만 머문 채 패키징·테스트 등 후방 산업군에 미치지 못하고 해외 파운드리 수익으로 고스란히 돌아가고 있다.

이 사업은 스타기업을 다수 배출했으며 국내 파운드리와 협력, 시스템 반도체 시제품 개발을 지원하는 것이다. 팹리스 기업의 엑소더스 현상은 대형 패키징 기업을 제외한 중견 패키징 및 테스트 기업의 기반까지 무너뜨리고 있다. 설계-소자-제작-패키징-테스트로 이어지는 반도체 산업 연결고리가 취약해져 반도체 산업의 기형 구조를 부추기고 있다.

중견 패키징 기업인 관계자는 패키징 기술 대만 파운드리 업체보다 월등히 뛰어나지만 팹리스 기업이 해외 파운드리를 주로 이용한 탓에 시스템 반도체 패키징 매출 성장 속도가 저조할 뿐더러 매출 구조도 메모리 패키징 분야에 쏠리는 부작용이 있다고 말했다. 패키지 기업의 매출에서 메모리 대 시스템반도체의 평균 매출 비율은 60~70% 대 30~40%로 추정하고 있다.

팹리스 기업이 해외 파운드리를 선택한 이유는 복합적이다. 우선 파운드리 사업을 하는 대기업이 정부 지원사업에 미온적이기 때문이다. 특히 0.13 μ m 이하 90·65 나노 미세 공정팹을 가진 파운드리 기업은 팹리스 기업 지원을 기피하고 있다. 팹리스 기업의 시스템반도체 시제품 개발 지원과 관련 지난해 0건, 올해 1건만을 진행했다. 파운드리 사용 비용이 대만 파운드리에 비해 30%가량 비싼 탓에 IP 유출 우려를 감수하면서까지 해외로 나가고 있는 것이다. 정부의 시제품 개발 지원금도 턱없이 부족한 편이다. 연평균 1기업당 1억 원을 지원하는데 0.13 μ m 공정라인을 이용하면 평균 40만 달러의 비용을 팹리스기업이 내야 한다.

한 팹리스 기업 관계자는 대형 파운드리 기업은 수지 타산과 효율성을 고려, 양산 물량이 많지 않으면 팹리스 기업의 시제품 제작 서비스 의뢰를 거절하고 있다며 팹리스 기업은 저렴한 가격에 우수한 라인을 사용하기 위해 해외로 눈길을 돌리고 있다고 말했다.